

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年12月24日(2015.12.24)

【公開番号】特開2014-96497(P2014-96497A)

【公開日】平成26年5月22日(2014.5.22)

【年通号数】公開・登録公報2014-027

【出願番号】特願2012-247764(P2012-247764)

【国際特許分類】

H 01 L 25/00 (2006.01)

H 03 H 7/075 (2006.01)

H 03 H 7/38 (2006.01)

【F I】

H 01 L 25/00 B

H 03 H 7/075 Z

H 03 H 7/38 Z

【手続補正書】

【提出日】平成27年11月9日(2015.11.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の出力パッドを有する半導体チップと、  
導電性のパターンを有する出力端子部品と、  
導電性のパターンを有する配線部品と、

それぞれの一端が前記出力パッドと接続され、それぞれの他端が前記出力端子部品の前記パターンの長手方向に対して分散して接続された第1ボンディングワイヤと、

前記配線部品の一部領域と前記出力端子部品の前記パターンとの間を接続する接続部と、

前記配線部品に接続された容量性部品と、を備えることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】

前記配線部品は、前記半導体チップと前記出力端子部品との間に配置され、その長手方向が、前記配線部品と前記半導体チップとが配置されている方向と交叉する方向に延在してなることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】

前記出力端子部品の前記パターンの幅は、前記配線部品の前記パターンの幅より大きいことを特徴とする請求項1又は2記載の半導体装置。

【請求項4】

前記半導体チップと前記出力端子部品との間隔は、前記出力端子部品の幅よりも小さいことを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項5】

前記容量性部品は、前記配線部品の長手方向に配置されてなることを特徴とする請求項2記載の半導体装置。

【請求項6】

前記接続部は、第2ボンディングワイヤからなることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

**【請求項 7】**

前記配線部品の一部領域は、前記配線部品の前記パターンの総延長の40%以下の領域であることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

**【請求項 8】**

前記出力端子部品の前記パターンの長手方向における幅は、前記配線部品の前記パターンの長手方向における幅より3倍以上大きいことを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

**【請求項 9】**

前記容量性部品は、前記半導体チップの温度特性の変化を補償する温度特性を有することを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

**【請求項 10】**

前記半導体チップが搭載されるパッケージを備え、  
前記パッケージはハーメチックパッケージであることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。